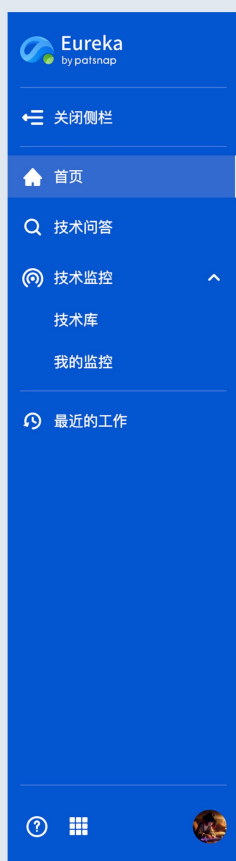


智慧芽 研发创新平台

快速操作指南



AI释放创新潜力

技术想法查新

有新的研发想法？30秒快速验证您的创新性并获得更多建议吧。

[快速开始 →](#)

交底书助手

1分钟内，理解扩展你的技术想法，并完成撰写交底书。

行业技术路线

帮助研发人员把握领域技术方向，提供数据支撑。

工作空间

管理你保存的专利论文，

技术问答 搜索

输入关于技术的问题，获取技术知识，技术信息和方案解答...

✳ DeepSeek R1 ▾

案例： 高温合金在涡轮发动机中的挑战？ 如何降低摩托车噪音？

版权声明

本文档版权归属智慧芽信息科技（苏州）有限公司，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式进行传播。

© 智慧芽信息科技（苏州）有限公司 2025。保留一切权利。

商标声明

本文档提及的"智慧芽"、"Patsnap"以及与之相关的商标均为智慧芽信息科技（苏州）有限公司的商标，非经智慧芽信息科技（苏州）有限公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用此类商标。

本文档提及的第三方所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意事项

本文档仅作为使用指导，本文档中描述的全部或部分产品、服务或功能可能不在您的购买或使用范围之内，您购买的产品、服务或功能等应以智慧芽信息科技（苏州）有限公司与您签订的正式合同为准。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非合同另有约定，智慧芽信息科技（苏州）有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证，且本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

智慧芽信息科技（苏州）有限公司

地址：苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 G3-701、G3-801、G3-901、G3-1001 单元

邮编：215123

网址：<https://eureka.zhihuiya.com/home>

目录

- 简介 1
- 1 注册登陆 2
 - 注册账号 2
 - 登录产品 2
- 2 公共功能模块（首页和导航栏） 3
 - 技术问答 3
 - 技术监控 5
 - 工作空间 7
- 3 技术保护模块 9
 - 技术想法查新 9
 - 交底书助手 11
 - 行业技术路线 13
 - 专利/论文搜索和阅读 14
- 结语 18

简介

智慧芽研发创新平台（以下简称为 Eureka），运用智慧芽领先的垂直领域自研 AI 大模型，整合海量论文、专利、新闻、行业报告等数据，融合前沿研发创新理论，为企业研发创新提供专业的研发工具和全面的支持服务。赋能企业明确战略研发方向，激发创新灵感，探索技术解决方案，防范技术风险，保护研发创新成果。

本手册将为您简要介绍 Eureka 技术保护模块的功能, 及对应的使用场景和步骤, 帮助您快速上手!



1 注册登陆

注册账号

进入产品官网<https://eureka.zhihuiya.com/home>，点击"免费注册"进行账号注册。

登录产品

Eureka 提供多种便捷的登录方式，您可以选择合适的方式进行登录：

1. 微信登录：使用微信扫描登录弹窗上的二维码，快速进入产品。
2. 短信验证码登录：输入手机号码，接收并输入短信验证码即可登录。
3. 其他方式：如果您需要使用邮箱，或您的公司配置了 SSO 或 CARSII 登录，请点击"其他登录方式"按钮，选择对应方式进行登录。



2 公共功能模块（首页和导航栏）

技术问答

一、 功能介绍

当您寻找新技术信息或者知识时，四处查找不仅耗时，还可能错过关键信息。Eureka 提供「**技术问答**」工具，帮您摆脱在多个网站间搜索的繁琐过程，一站式获取技术新知识、新技能、新可能。

二、 使用步骤

Step 1 输入技术问题或想要查找的技术信息，例如"人工智能在传统产业中的研发方向有哪些"、"高温合金在涡轮发动机中的挑战？"点击"询问"。



Step 2 进入结果页阅读技术答案，每个答案都有对应的来源支撑，点击查看详情。



Step 3 当您想要更深入地探索技术方案的实现细节，点击"定制我的技术方案"。



更多使用小技巧：

-  **分享**：点击分享，轻松将您的新发现分享给研发小伙伴。

技术监控

一、功能介绍

在技术革新的浪潮中，错过最新技术情报，可能让您错过关键机会。Eureka 提供「**技术监控**」工具，知己知彼，不错过竞争对手或者行业的重要更新。

「**技术库**」涵盖多个行业领域的技术报告、核心发明点及分析洞察。此外，「**我的监控**」，自定义关键词监控，亿级数据实时更新，技术情报一手掌握。

二、使用步骤

技术库

在左侧导航栏「技术监控」栏位，点击"技术库"，找到您的技术领域，点击"订阅"，每周我们将给您推送订阅领域的最新研发动态，帮助您不错过重要更新。



及时掌握最新研发动态，把握竞争先机

每周，您将收到已订阅领域的最新研发动态，包括最新的发明点，与分析洞察。

全部 (194) 计算机视觉 (17) 智能驾驶 (10) 储能 (31) 材料 (34) 医疗设备 (8) 动力转换 (14) 半导体 (12) 光学 (17)

电力电子设备 (3) 车辆 (9) 光电 (39)

晶圆 - 制备工艺

晶圆子领域: 晶圆切割、载板、切片、晶圆研磨、磨片、抛光、晶圆检测、晶圆检测、晶圆检测

半导体清洗

晶圆子领域: 湿法清洗、干法清洗

半导体薄膜 - 分类

晶圆子领域: 介电膜、半导体膜

半导体外延 - 分类

晶圆子领域: 外延外延、同层外延

半导体沉积 - 工艺

技术库 / 技术领域: 半导体外延 - 分类

2D-Mg掺杂提高了p型GaN的导电性，新型高级印刷电子技术

分享 + 订阅

1. 技术创新

- 隧穿复合结(TJR): TJR是串联太阳能电池中的关键组件，有助于不同材料层之间的电荷载流子复合，以改善能量转换并减少复合损失，这对于实现更高的设备效率至关重要。
- 2D-Mg掺杂GaN超晶格 (MIGs): 名古屋大学发现的这种新型结构涉及将单层石墨烯的碳插入到GaN电子特性，还引入了新的掺杂和应变机制。这些机制可以显著提高导电性，可能还能增强其他半导体特性。
- TCAD Sentaurus 和 GenPro4 建模: 这些软件工具用于模拟半导体器件的光学和电学特性。通过它可以预测材料属性和器件结构的变化如何影响性能。这对于识别串联太阳能电池中的损耗机制和制造制造。因为它能够以较低的成本制造出高性能的柔性电子设备。
- 单晶钙钛矿/IGS 叠层太阳能电池: 这项技术将两种不同类型的太阳能电池 (钙钛矿和IGS) 结合旨在利用两种材料的优势，最大化光吸收和转换效率。代尔夫特理工大学的研究人员正在优化界面和体性能。

相关技术领域的最新技术发布

全部 (0) 异质外延 (0) 同层外延 (0) 应变外延 (0) 金属外延 (0) 金属有机化学气相沉积

智慧芽 Eureka 技术洞察员

原位应变控制在外延硅碳化物化合物半导体中，准备迎接可弯曲透明微型 LED 显示屏

收件人: 智慧芽 Eureka 技术洞察员

回复给: 智慧芽 Eureka 技术洞察员

提示: 在浏览器中，轻松查阅最新技术动态，包括创新点解读与分析洞察。请点击打开浏览器。

半导体外延 - 分类

3 篇新闻，5 个子领域的首次公开技术

01 热点技术动态

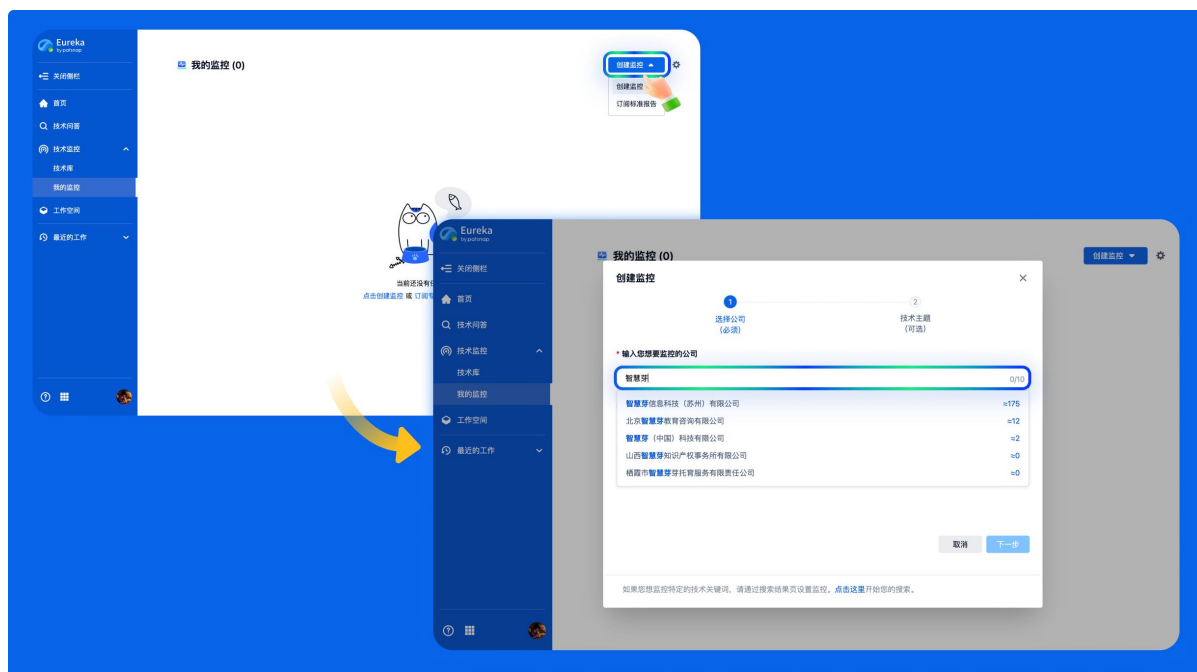
我们精选了3篇关于半导体外延 - 分类领域最新发展的新闻文章。这些文章从技术创新和对用户的影响2个角度进行了分析。通过分析，我们总结出以下几点要点:

技术创新

- 材料表征技术
- 皮秒超声技术等方法可以提供关于薄膜与基底之间粘合质量的关键数据，这对于评估影响整体设备性能的机械属性至关重要。
- MicroLED 显示技术

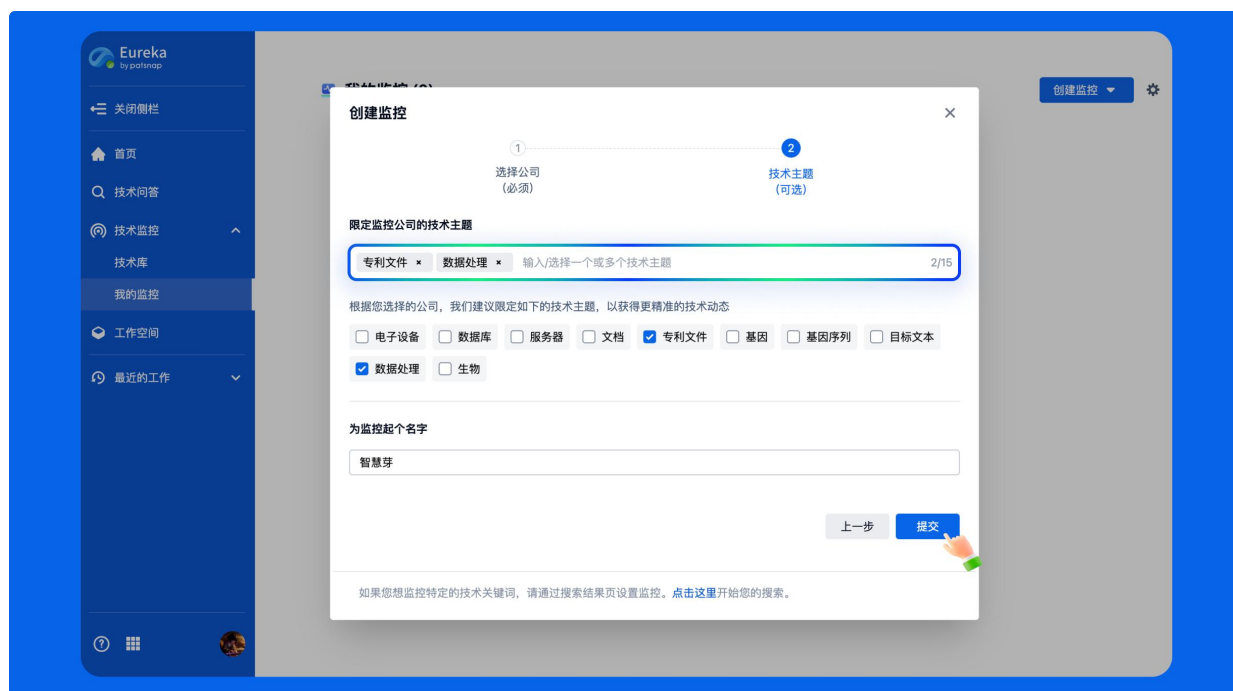
我的监控

Step 1 在左侧导航栏「技术监控」栏位，点击"我的监控"，输入并选择要监控的公司（必填）。



Step 2 输入技术关键词或技术主题（可选），点击"提交"。

（有任何技术情报更新，每周一您会收到邮件提醒。）



工作空间

一、功能介绍

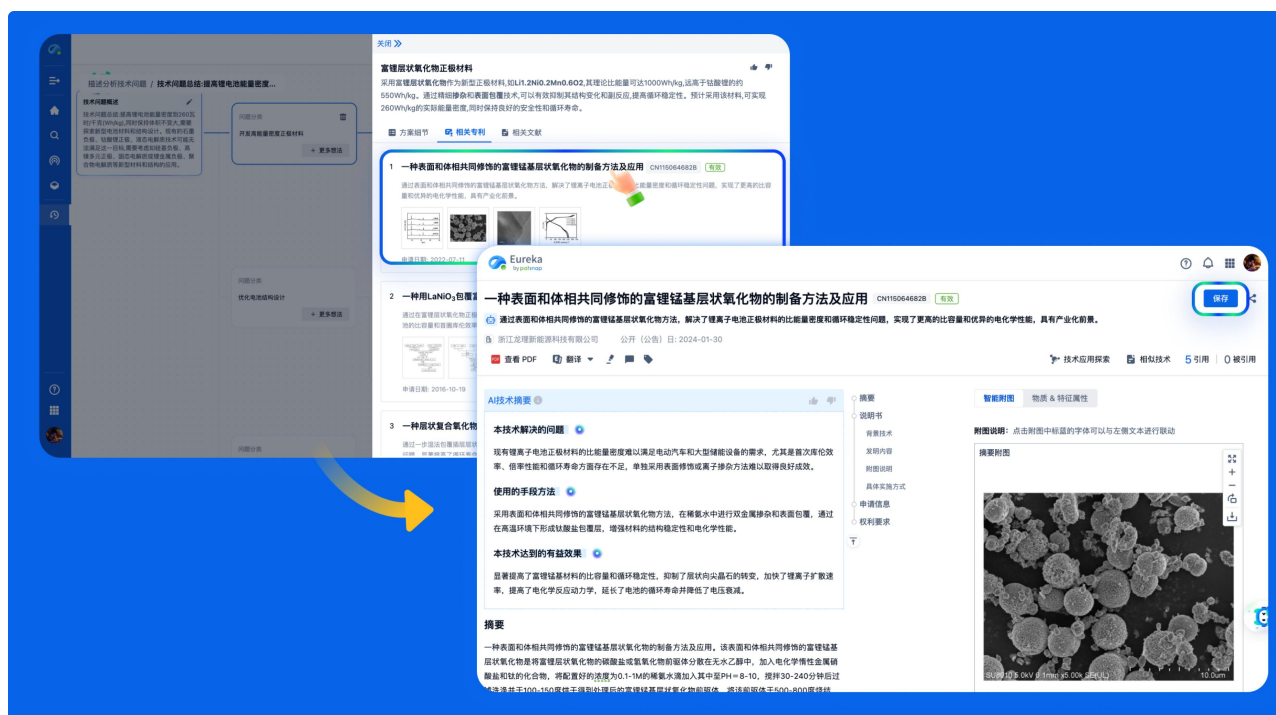
在研发过程中，团队协作解读、标注批量技术方案时，缺乏一个协同空间，导致协作效率低下，亦或者想要保存自己发现的技术方案，想要再次阅读却没有便捷方式。

Eureka 提供「工作空间」工具，支持您一键保存、标引、分享目标技术方案，方便团队随时访问和协作。

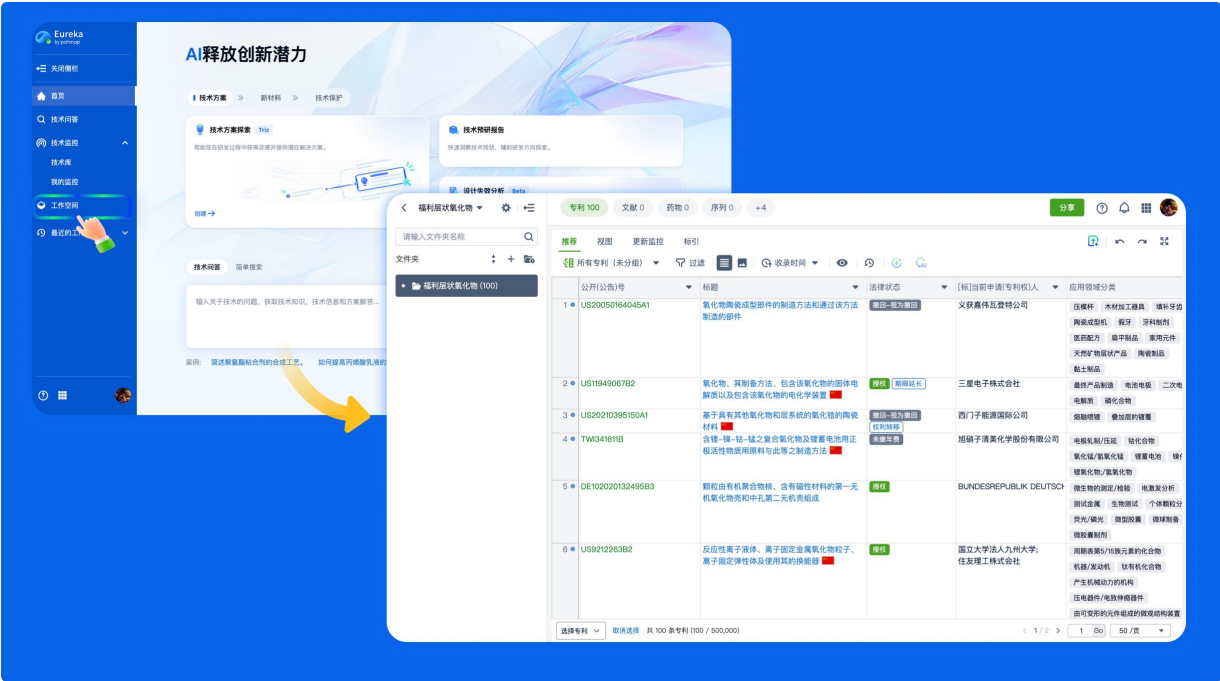
二、使用步骤

保存技术方案

Step 1 在技术方案详情页，点击"保存"，创建或者选择工作空间及文件夹，点击"确定"。

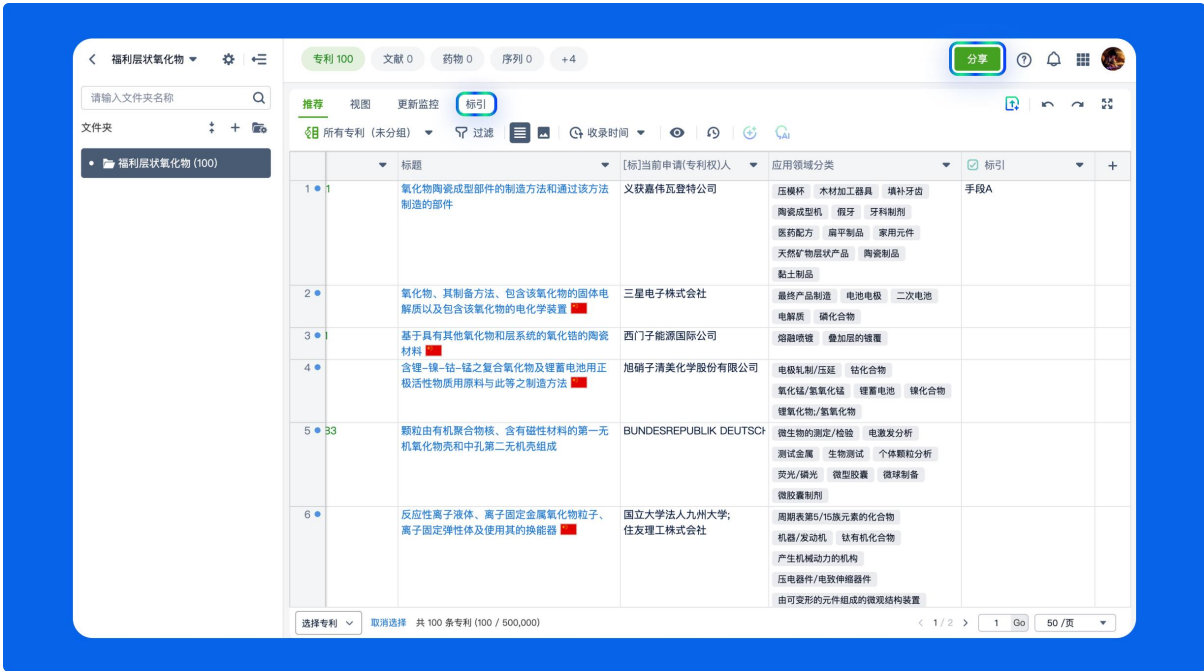


Step 2 想要再次阅读之前保存的方案？点击左侧导航栏「工作空间」，选择文件夹，找到技术方案，点击即读。



协作标引、解读方案

在工作空间点击"分享"，输入团队成员邮箱，轻松把工作空间分享给团队，一起协作标引、解读。



3 技术保护模块

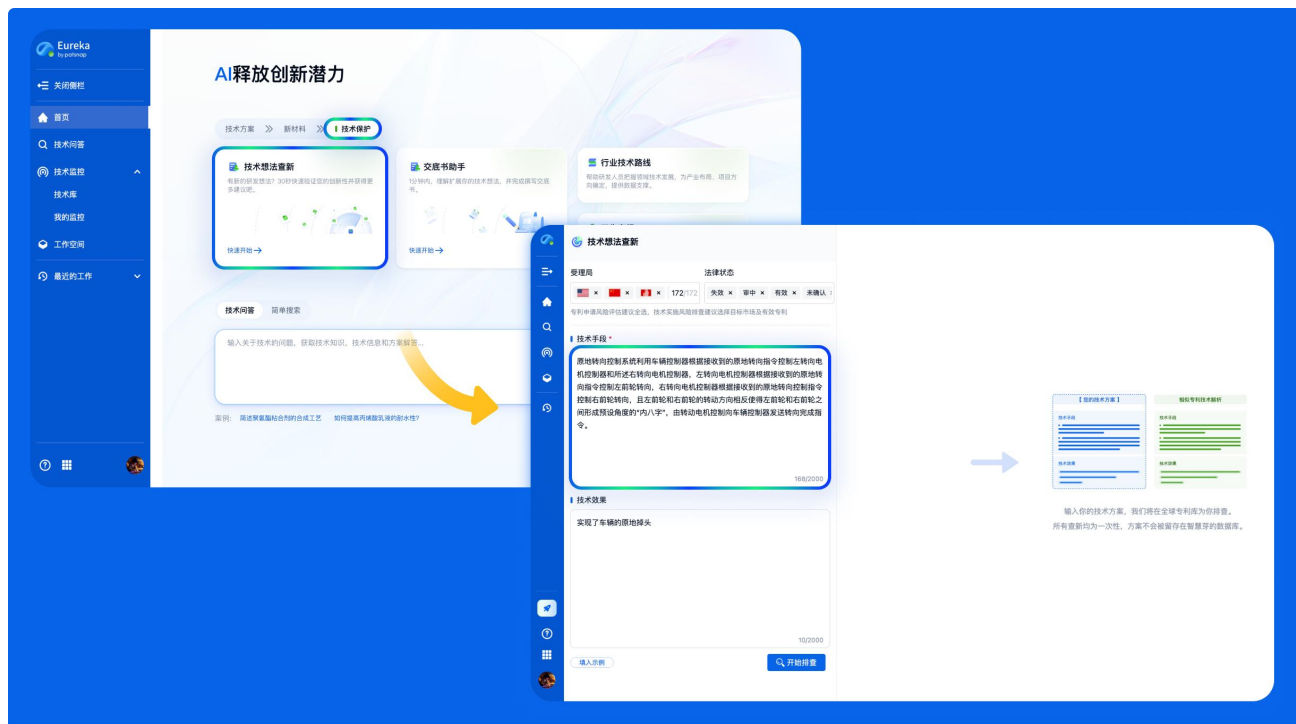
技术想法查新

一、功能介绍

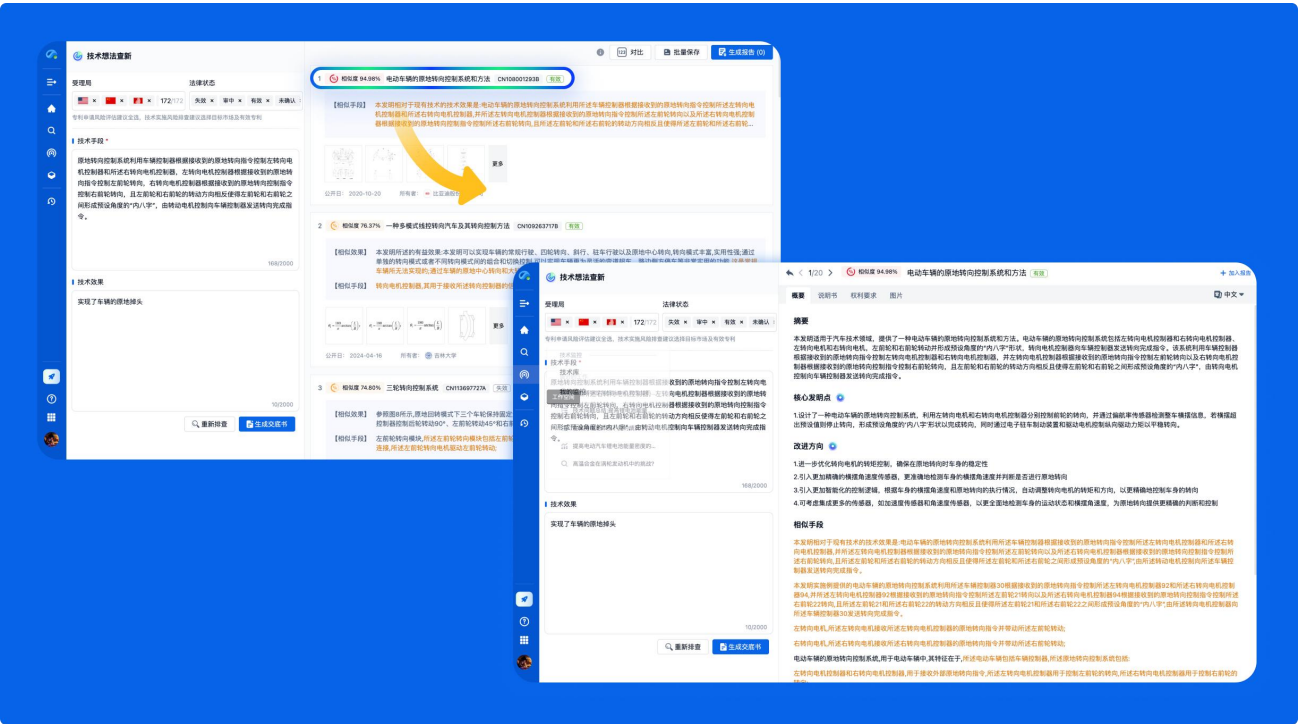
当您有一个技术创意时，不确定能否申请专利保护。Eureka 提供「技术想法查新」工具，智能甄别想法相似度，提供改进建议，提升专利申请授权概率。

二、使用步骤

Step 1 在技术保护模块，点击「技术想法查新」，输入技术手段（必填）、期望达到的技术效果（可选），然后点击"开始排查"。



Step 2 为您展示最相似的 20 篇专利文本，并高亮出相似段落，点击标题进一步查看详细信息。



Step 3 选择相似的专利方案加入对比分析报告，点击右上角"生成报告"生成全面专业的查新报告，同时支持报告的下载与分享。



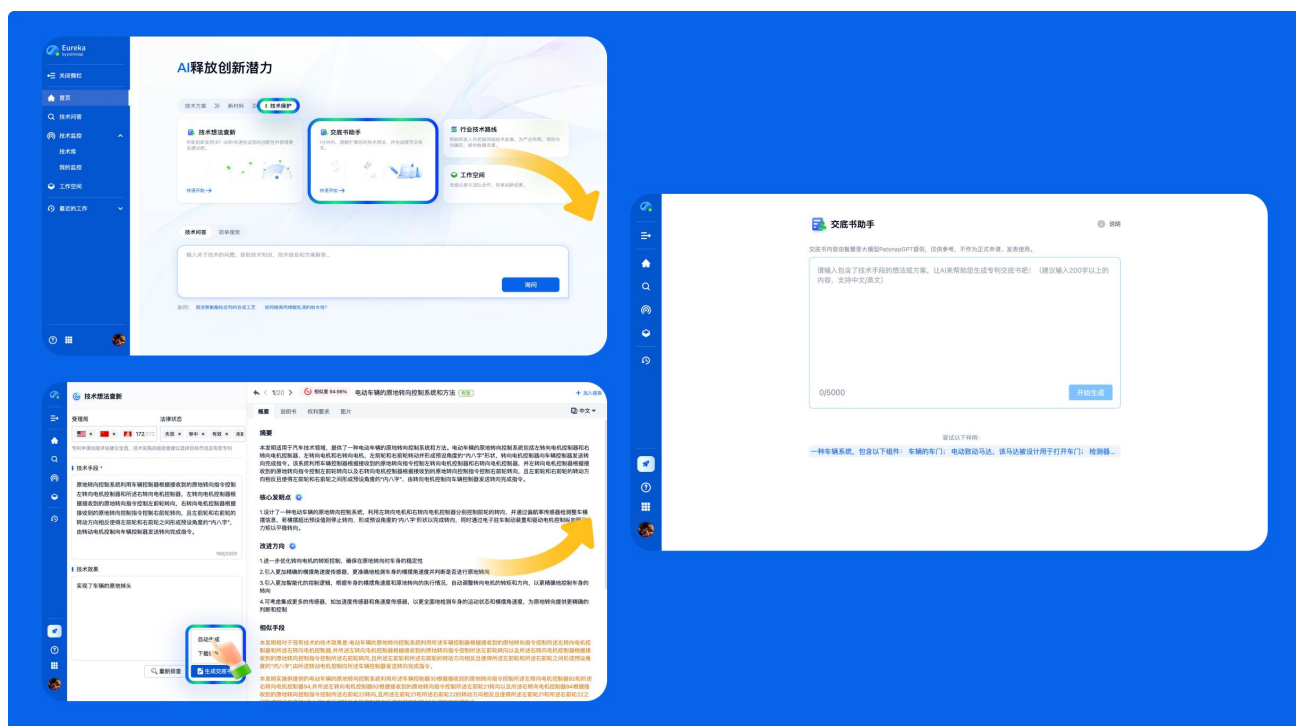
交底书助手

一、功能介绍

在申请专利前，编写详尽且专业的技术交底书既关键又繁琐。Eureka 提供「**交底书助手**」工具，一键生成专业的技术交底书，成为您专利申请过程中的得力助手。

二、使用步骤

Step 1 在技术保护模块，点击「交底书助手」，或者从技术查新结果页进入该页面。

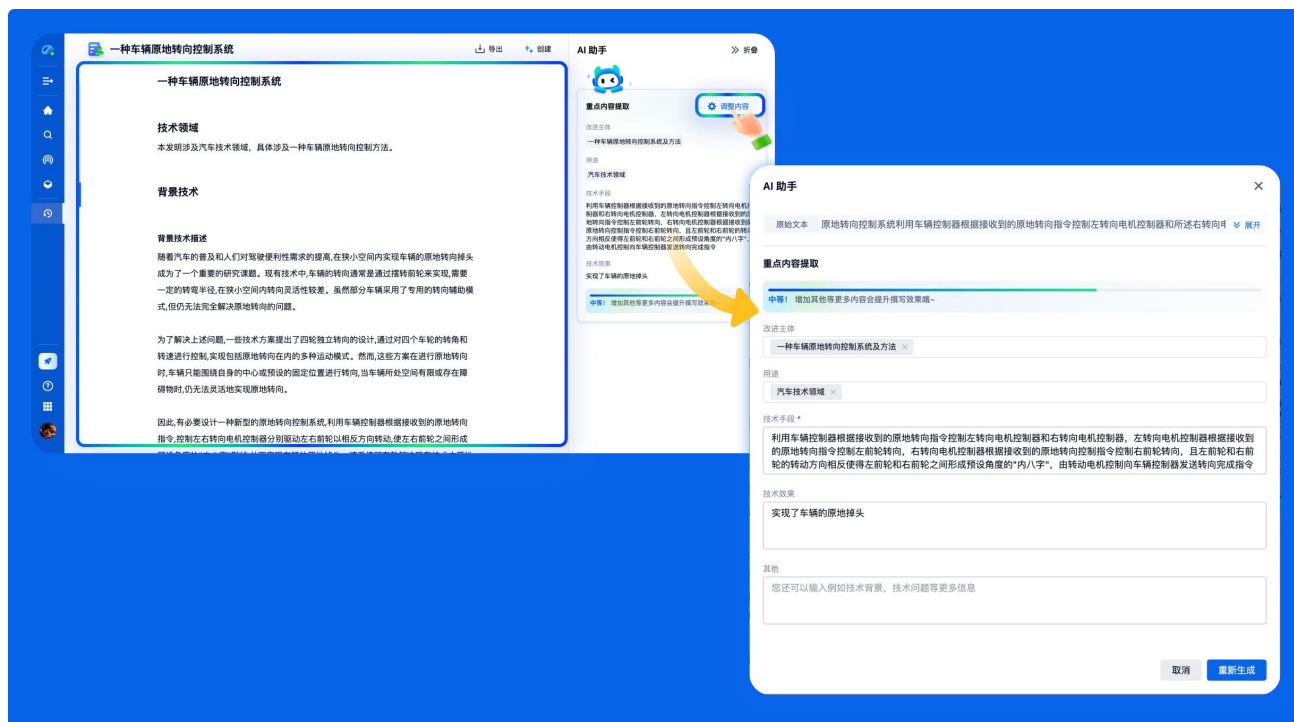


Step 2 简单描述您的技术方案，点击"生成"，AI 智能撰写交底书。

(为了更好的生成效果，建议您输入 50 字以上的内容描述)



Step 3 点击"编辑"进行改写，再次生成结果后点击上方"下载"按钮即可下载完整的技术交底书。



行业技术路线

一、功能介绍

想要速览行业技术发展路径？Eureka 提供「行业技术路线」工具，依据专利引用量、同族数、专利价值等多维度，融合行业经验，为你精准呈现技术发展脉络。

二、使用步骤

在技术保护模块，点击「行业技术路线」，点击创建路线图，选择检索条件进行线路图绘制，支持从"企业"、"技术主题"、"关键词"、"技术周期"四个维度进行创建。

The screenshot displays the Eureka platform's 'Industry Technology Route' tool. The main interface features a sidebar on the left with navigation options. The central area is titled 'AI释放创新潜力' and includes a '行业技术路线' section with a '创建路线图' button. A '我的路线图 (12)' section shows a grid of technology route maps. Below this, a '创建路线图' dialog box is visible, allowing users to select search criteria: '企业' (Company), '技术主题' (Technology Theme), '关键词' (Keywords), and '技术周期' (Technology Cycle). The dialog also includes a '创建路线图' button. In the background, a table titled '集成电路封装' (Integrated Circuit Packaging) is shown, detailing technical developments from 1998 to 2005. The table has columns for '技术主题' (Technology Theme) and years. The content of the table is as follows:

技术主题	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
印刷电路	对于印刷电路封装技术的研究，主要集中于如何提高封装效率和降低成本。研究重点包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。
电气设备和连接器件	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。
金属加工设备	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。	随着封装技术的不断进步，研究重点转向了如何提高封装的可靠性和寿命。主要研究方向包括：1. 优化封装工艺，提高生产效率。2. 采用新型封装材料，降低材料成本。3. 改进封装结构设计，提高散热性能。4. 探索新的封装技术，如倒装芯片等。

专利/论文搜索和阅读

一、功能介绍

在研发过程中，当您想要从海量的文献中快速找到相关专利/论文，常常面临数据更新时效、信息过载等问题。Eureka 提供「简单搜索」、「高级搜索」、「图像搜索」工具，快速定位全球论文和专利文献。

二、使用步骤

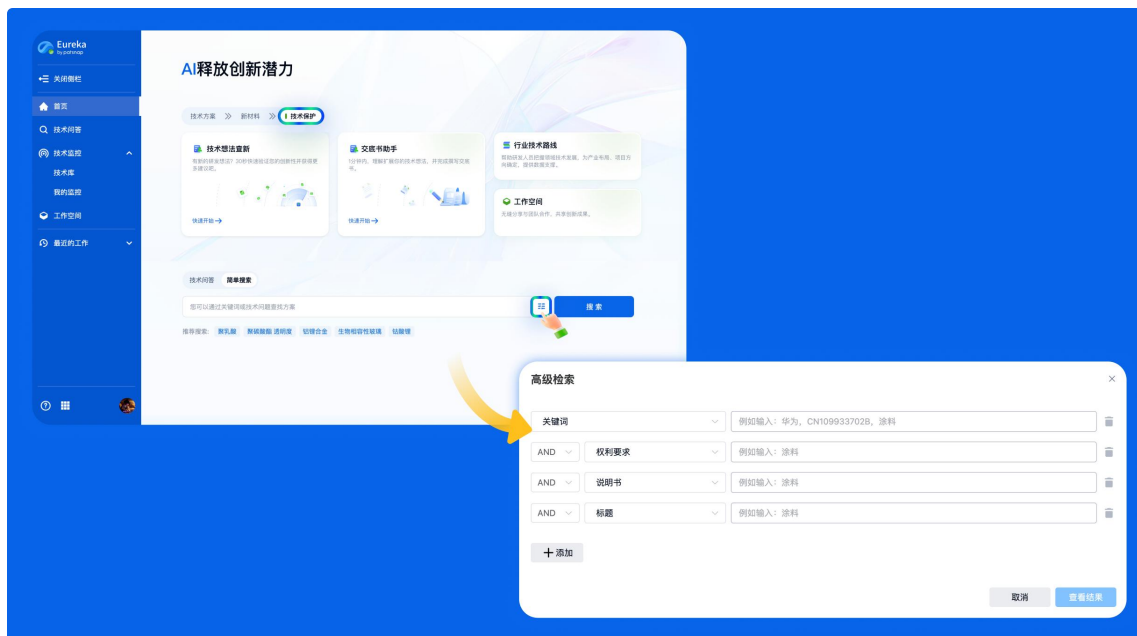
搜索

在技术保护模块，点击「搜索」，输入技术关键词或公司名，点击"搜索"，进入结果页。



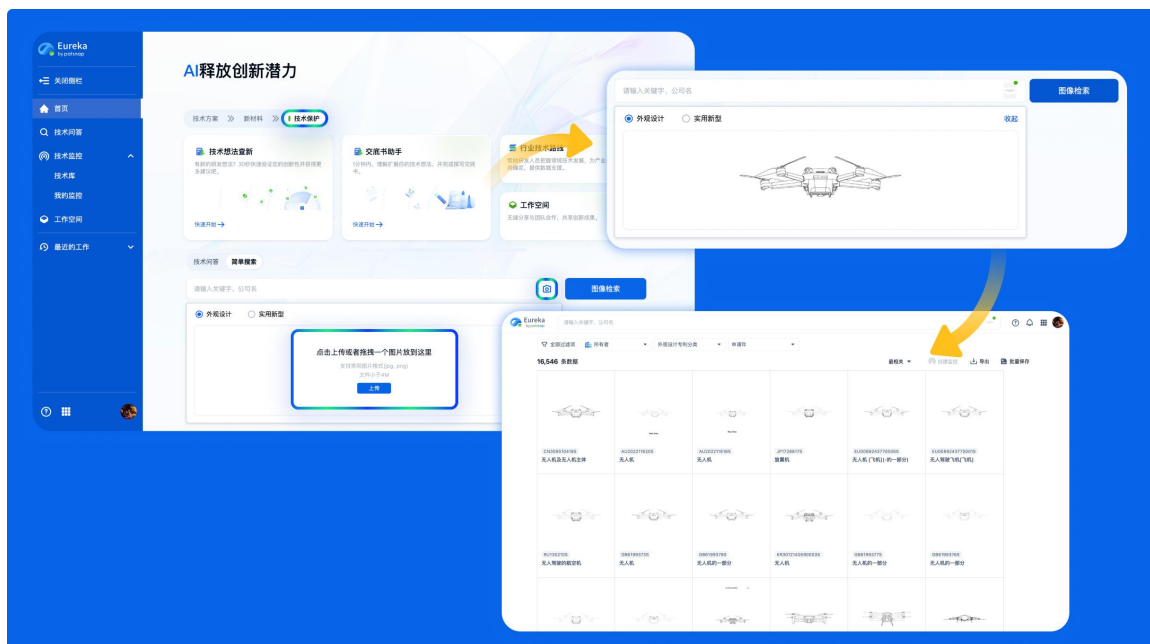
高级搜索

在技术保护模块，点击  按钮，设置好检索字段，输入关键词，点击"查看结果"，进入结果页。



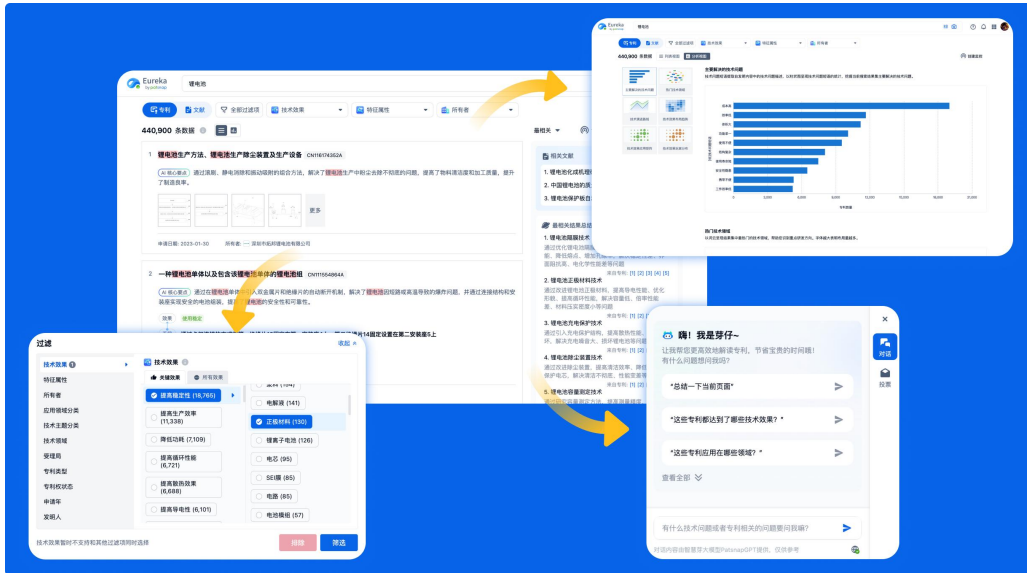
图像搜索

点击  按钮，上传图片进行检索，点击图像检索，查找符合条件的外观设计或实用新型专利。



检索结果页

在搜索结果页，为您呈现搜索到的专利、论文文献或者公司信息。「分析视图」、「最相关总结」概览专利分布，「过滤项」进行精准筛选，更有「AI 助手芽仔」为您提供服务。



更多使用小技巧：

-  **创建监控**：点击针对当前搜索结果创建监控看板，持续关注技术情报。

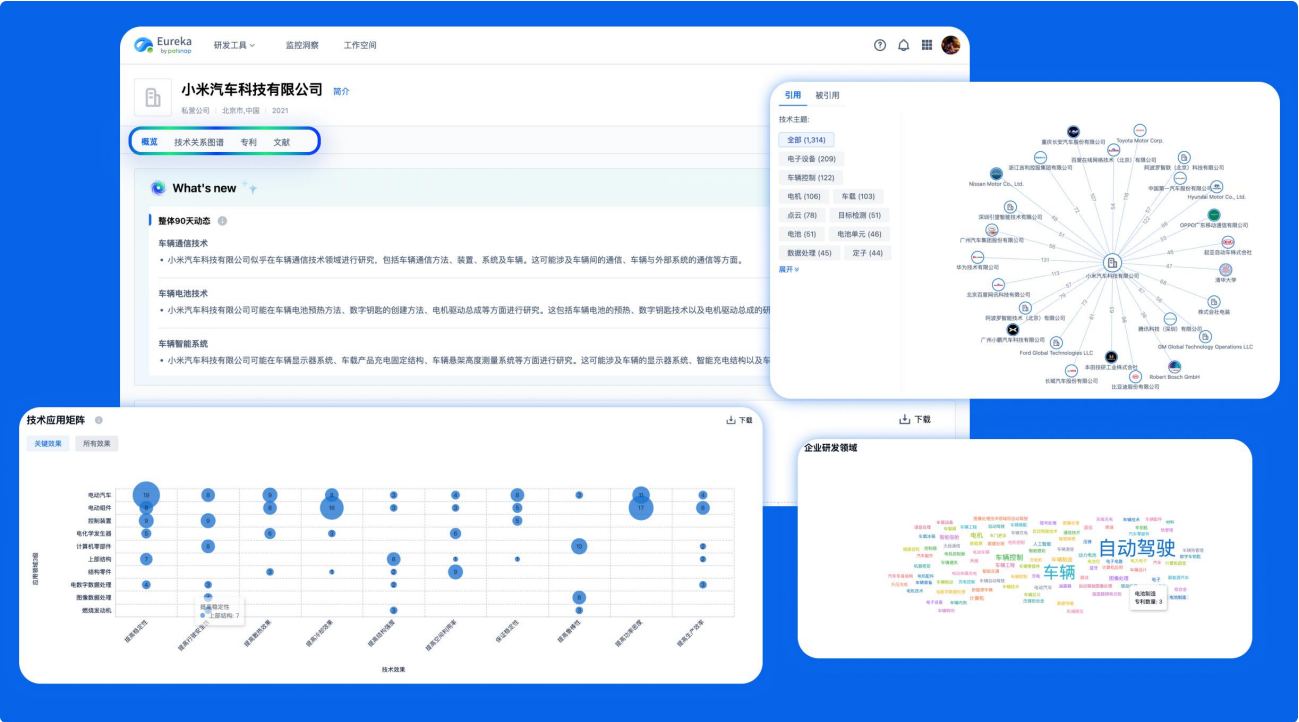
专利/论文详情页的阅读

在专利/论文详情页，「AI 技术摘要」、「智能附图」和「特征属性/实施例」等功能，帮助您一分钟了解技术要点内容，更有「AI 助手芽仔」为您提供服务。



公司详情页的阅读

在公司详情页，「技术应用矩阵」、「技术关系图片」等信息，帮助您详细了解目标公司的研发动态、合作情况，全方位了解公司技术脉络。



结语

您在使用过程中有任何问题或者建议，欢迎通过咨询电话或邮箱的方式与我们联系，我们会为您提供专业及时的支持服务。

咨询电话：400-694-4481

邮箱：eureka@patsnap.com



扫码关注智慧芽 Eureka 微信公众号

获取产品最新动态